

2011年(平成23年)11月7日(月曜日)

日 刊



発行所 電波新聞社  
 東京本社  
 東京都品川区東五反田1-11-15 千141-8715  
 ☎03(3445)6111(大代表)

大阪本社  
 大阪府中央区北落3-2-25 (京阪淀屋橋ビル6階) 千541-0041  
 ☎06(6203)3361(大代表)

西部本社  
 福岡市博多区博多駅前2-13-23 (扇寿ビル) 千812-0011  
 ☎092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2006

### 千住金属工業

千住金属工業は、2000年に鉛(Pb)フリーはんだの標準的な「M705」を商品化し、電子部品や電子機器の鉛フリー化に

と耐熱疲労性を確保するはんだ組織中のAgCuSn化合物量も減少させ、接合部の長期信頼性低下を招く恐れから、低Agソルダーペーストの導入が遅れていた。

同社は低コスト、高信頼

## 高信頼・高作業性を兼備

スタート  
 パースト  
 耐熱  
 疲労性  
 従来(M705)と同等以上

ひと役買って来た。

料を使用したSnCu系は、高作業性を兼ね備えた

現在、Pbフリー実装に  
 はんだの導入が進んでいる。  
 SnAgCu系ははんだが  
 定着しているが、主要元素  
 は、溶融温度の上昇と濡れ  
 性、高作業性を兼ね備えた

はんだ中のAg量の低下  
 は、溶融温度の上昇と濡れ  
 性、高作業性を兼ね備えた

であるSn(Sn)やAg  
 (銀)の価格が世界的な資  
 源高騰機運の高まりを受け  
 て大幅に上昇しており、市  
 場の関心は、はんだ材料の

性を劣化が懸念される。加  
 えて低銀化は、バルク強度  
 微量なBi(ヒスマス)、



千住金属工業の低銀はんだ材料

な3元素Sn  
 AgCu系低  
 Agはんだよ  
 りも低く抑え  
 た。

同社の低A  
 gソルダーペ  
 ーストは、融  
 点、信頼性、  
 コストパフォ  
 ーマンス全て  
 のバランスに  
 優れた1%Ag  
 の「M40」と、より

In(インジウム)などの  
 添加で、接続信頼性の向上  
 と低融点化を図った。

結果、Ag含有率の低下  
 にもかかわらず、従来の3  
 %Ag(M705)はんだ  
 と同等以上の耐熱疲労性を  
 実現し、温度上昇も一般的  
 している。